



# INVITACIÓN



Congreso de  
Métodos Numéricos en Ingeniería (CMN)  
25 – 28 Junio, 2013  
Bilbao, España



**SEMNI**  
Sociedad Española de  
Métodos Numéricos  
en Ingeniería  
**25 años**





## Bienvenido a CMN 2013!

El Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2013, organizada conjuntamente por las asociaciones Española (SEMNI) y Portuguesa (APMTAC) de métodos numéricos, será un punto de encuentro para researchers and technicians de ambos países y la comunidad de América. Su objetivo es actuar como un foro para recoger relevantes avances científicos y técnicos en los métodos numéricos y en los campos de la mecánica computacional.

Las ediciones previas del Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería tuvieron lugar en Madrid (2002), Lisboa (2004), Granada (2005), Porto (2007), Barcelona (2009) y Coimbra (2011).

El congreso precede al 25 aniversario de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI) en el año 2014. Así, coincidiendo con esta fecha, del 20-25 de julio de 2014 se celebrará en Barcelona el 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCMM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V) y 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECCFD VI).

## Organizadores



[Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería \(SEMNI\)](#)



[Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional \(APMTAC\)](#)



Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
Bilbao

[Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao \(ETSI\)](#)

## Comité Organizador

### SEMNI

Jesús María Blanco, *UPV/EHU, Bilbao, Spain*

Alberto Peña, *UPV/EHU, Bilbao, Spain*

Irene Arias, *UPC, Barcelona, Spain*

### APMTAC

José Miranda Guedes, *IST, Lisbon, Portugal*

Nuno Silvestre, *IST, Lisbon, Portugal*

Miguel Silva, *IST, Lisbon, Portugal*



## Sesiones Temáticas

Métodos avanzados de discretización

Vidrio estructural

Métodos numéricos en mecánica de contacto

Algoritmos genéticos

Estimación del error a posteriori y la adaptividad de la malla

Nanomecánica

Dinámica de fluidos computacional

Dinámica estructural y de fractura

Micromecánica de defectos en materiales

Elasticidad y resistencia de materiales

Elasticidad, comportamiento no lineal y dimensionamiento de estructuras metálicas

Mecánica de la fractura

Acero y estructuras compuestas

Fluidos no newtonianos y glaciología

Geotecnia

Métodos computacionales en acústica y vibraciones

Mecanobiología computacional e ingeniería de tejidos

Técnicas de reducción de modelos en ingeniería

Métodos computacionales en mecánica experimental

Método de los elementos finitos en problemas de convección-difusión

Optimización estructural y multidisciplinar

Métodos numéricos para turbomáquinas y flujos rotativos

Biomecánica computacional y aplicaciones

Modelado numérico del comportamiento no lineal del hormigón

Hormigones con fibras

Métodos numéricos para problemas de Electromagnetismo

Materiales compuestos

Modelado de procesos en zonas cercanas a la costa

Métodos numéricos en ingeniería de presas

Procesamiento de imágenes y visualización

Biomecánica y biomecatrónica

Problemas inversos y evaluación no destructiva

Mallado adaptativo: generación y refinado

Análisis Isogeométrico

Simulación de procesos de conformado

Transferencia de calor y de masa

Geomateriales

Aplicaciones a la ingeniería electrónica

Ingeniería de la construcción

Estampado incremental

Flujo en medios porosos

Redes neuronales

Ingeniería del medio ambiente

Ingeniería del transporte

Comportamiento de estructuras de pared fina

Dinámica multi-cuerpo

Hidráulica computacional

Materiales de contacto

Comportamiento dinámico de materiales

Estructuras de polímeros

Métodos paralelos de álgebra lineal

Métodos sin malla

Modelación de procesos biológicos y de biomimética

Modelación numérica en ingeniería de seguridad contra-incendios

Oceanografía e ingeniería costera

Métodos residuales para ecuaciones diferenciales

Problemas acoplados y/o de paralelización

Ingeniería sísmica



## CONDICIONES DE PATROCINIO CMN 2013

### A) Paquetes de Patrocinio

Se han establecido tres niveles de paquetes de patrocinio para este congreso: PLATINO, ORO y PLATA.

#### **Patrocinio PLATINO:**

**7,000 €.-**

Incluye:

- Espacio de la exposición con opción preferente de asignación y tamaño en el área designada.
- 2 inscripciones al congreso, incluyendo la recepción de la bolsa del congreso con todos los documentos del congreso, acceso libre al cóctel de bienvenida, cafés, comidas y banquete.
- Presentación de los últimos desarrollos y productos a su público objetivo con un discurso de 45 minutos. El intervalo de tiempo será asignado para su empresa de forma paralela al programa del congreso. Se le proporcionará una sala de lectura adecuada y el equipo técnico estándar, y anunciado tanto en el programa final, como en la página web del congreso.
- Reconocimiento como "Patrocinio Platino" con el nombre más grande de la empresa y el logo en la página web del congreso, y durante la presentación del congreso.

#### **Patrocinio ORO:**

**5,000 €.-**

Incluye:

- Espacio de la exposición con opción preferente de asignación después de los Sponsors Platino.
- 1 inscripción al congreso, incluyendo la recepción de la bolsa del congreso con todos los documentos del congreso, acceso libre al cóctel de bienvenida, y a los cafés.
- Reconocimiento como "Patrocinio Oro" con el segundo nombre más grande de la empresa y el logo en la página web del congreso, y durante la presentación del congreso.

#### **Patrocinio PLATA:**

**3,000 €.-**

Incluye:

- Espacio de la exposición con opción preferente de asignación después de los Sponsors Platino y Oro.
- Reconocimiento como "Patrocinio Plata" con el tercer nombre más grande de la empresa y el logo en la web del congreso y durante la presentación del congreso.

### B) Ítems de Patrocinio

Su empresa puede elegir una combinación de diferentes ítems para patrocinar, dependiendo del mencionado nivel, tales como:

#### **Soporte al banquete del congreso**

**5,000 €.-**

El banquete del congreso tendrá lugar el Jueves 27 de Junio, en los nuevos espacios del Centro Internacional de Congresos Euskalduna. Este es el principal evento social del congreso y representa una oportunidad única para dejar una impresión duradera a todos los participantes. Habrá actuaciones especiales durante el evento. Sus rótulos se pueden instalar en la zona del banquete, y se hará una mención especial durante el parlamento de la entrega de premios.

#### **Soporte al cóctel de bienvenida del congreso**

**4,000 €.-**

El cóctel de bienvenida es un evento muy concurrido y animado del congreso. No hay sesiones científicas durante ese tiempo, para permitir que tanto participantes como patrocinadores, dispongan de tiempo para interactuar con otros colegas.



### **Soporte a las plenarias del congreso**

**3,000 €–**

Las plenarias son sesiones muy concurridas por la mañana donde científicos conocidos darán charlas de alto nivel relacionados con temas específicos en métodos numéricos. Los plenarios vienen de todas las partes del mundo, por lo que sus gastos (viaje y alojamiento) están cubiertos por la organización del congreso. Sus rótulos se pueden instalar en el auditorio.

### **Soporte a los cafés y comidas del congreso**

**2,000 € .–**

Los cafés ofrecidos dos veces al día (mañanas y tardes) y las comidas ofrecidas una vez al día (mediodía) a todos los participantes del congreso, representan un momento de relax para interactuar con sus colegas. Su apoyo será mostrado con rótulos en el área designada.

### **Soporte a los “bag inserts” del congreso**

**1,000 €–**

El tríptico o pequeño folleto de su empresa con una medida máxima A4, será insertado dentro de cada bolsa, que será distribuida a todos los participantes del congreso. El número final y los detalles de envío serán confirmados a su debido tiempo.

## **C) Condiciones de Pago**

Todos los precios mencionados son netos (IVA excluido).

Todas las órdenes enviadas con el formulario de solicitud de patrocinio son vinculantes y no pueden ser canceladas.

El pago se efectuará a la recepción de la factura a:

**I.B.A.N.:** ES34 0019 0029 19 4128000891

**Código Swift:** DEUTESBBXXX

**Titular:** Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI)

**Banco:** DEUTSCHE BANK

**Sucursal:** PASEO MANUEL GIRONA 10, 08034 BARCELONA, SPAIN (EU)

### **Importante:**

- Todos los gastos bancarios son responsabilidad del participante y deberán ser pagados además de la cuota de inscripción.
- Por favor recuerde indicar “CMN 2013” y el nombre de “su compañía” en la referencia cuándo realice la transferencia.
- El comprobante de pago de la transferencia bancaria deberá ser enviado a la Secretaría del Congreso por email o fax.

**Para más información sobre opciones de patrocinio o para un paquete de patrocinio personalizado que se adapte a sus necesidades específicas de marketing, contacte con:**

Cristina Forace y Laia Aranda

Secretaría del Congreso

Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI)

Ed. C-1, Campus Norte UPC

C/Gran Capitán, s/n, 08034 Barcelona, España

**Tel:**+34 93 405 46 96 **Fax:** +34 93 205 83 47

**E-mail:** [cmn\\_2013@cimne.upc.edu](mailto:cmn_2013@cimne.upc.edu)

More information available at the **Conference Website:**

[http://congress.cimne.com/cmn\\_2013](http://congress.cimne.com/cmn_2013)



### Formulario de Patrocinio CMN 2013

 Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería <b>25 años</b>	Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI) Edificio C-1, Campus Norte UPC C/Gran Capitán, s/n, 08034 Barcelona, Spain <b>Tel:</b> +34 93 405 46 96 <b>E-mail:</b> cmn_2013@cimne.upc.edu <b>Fax:</b> +34 93 205 83 47
---	--

<b>Empresa:</b>	
<b>CIF (UE):</b>	
<b>Dirección de facturación:</b>	
<b>Código postal:</b>	
<b>Ciudad:</b>	
<b>País:</b>	
<b>Teléfono:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>Email:</b>	
<b>Persona de contacto:</b>	

**Niveles de Patrocinio:**

	PLATINO
	ORO
	PLATA

**Items Patrocinio:**

	Banquete (5,000 €)
	Cóctel de Bienvenida (4,000 €)
	Plenarias (3,000 €)
	Cafés y comidas (2,000 €)
	"Bag inserts" (1,000 €)

<b>Fecha:</b>	<b>Sello de la empresa:</b>	<b>Firma de un representante oficial:</b>